

第 25 回流動化・粒子プロセッシングシンポジウム (FB25)

第 14 回反応装置・プロセスシンポジウム

講演・参加募集のご案内

主催 化学工学会粒子・流体プロセス部会 流動層分科会

共催 化学工学会反応工学部会 触媒反応工学分科会

大阪大学大学院工学研究科 (依頼中)

協賛 日本機械学会, 粉体工学会, 日本粉体工業技術協会, 火力原子力発電技術協会, 石炭エネルギーセンター, 日本エネルギー学会, 日本混相流学会, 資源・素材学会, 触媒学会, 石油学会, 日本燃焼学会, 日本流体力学会, 日本セラミックス協会, 廃棄物資源循環学会, 日本薬学会, 日本鉄鋼協会, 日本計算工学会, ファインバブル学会連合 (依頼中を含む)

日時 2019 年 11 月 28 日 (木), 29 日 (金)

会場 大阪大学豊中キャンパス 大阪大学会館

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-13, <https://facility.icho.osaka-u.ac.jp/daigaku-hall/index.html>
阪急宝塚線「石橋駅」および大阪モノレール「柴原駅」から徒歩約 15 分

講演募集内容

本シンポジウムは流動層ならびに粒子(粉体)プロセッシングに関する技術的・学術的知識の交換と討論を目的としております。次の 5 分野に関連する講演を募集いたします。講演は口頭またはポスター形式で行い、討論を活性化する内容であれば、既発表の内容も歓迎いたします。なお、学生からの優秀なポスター発表に対して、優秀ポスター賞を贈賞します。

1. 流動層に関連する工学・技術
2. 反応工学・プロセスシステム
3. 粒子(粉体)プロセスの基礎と応用
4. 気泡・液滴・微粒子分散工学
5. 医薬品・バイオエンジニアリング

講演申込み締切 ~~2019 年 8 月 30 日 (金)~~ 2019 年 9 月 10 日 (火)

以下の各項目について、シンポジウム HP からご登録ください。

- 1) 題名、著者名、著者の所属 (和文)
- 2) 題名、著者名、著者の所属 (英文)
- 3) 300 字程度の和文要旨または 200 ワード程度の英文要旨
- 4) 代表者連絡先 (郵便番号、住所、氏名、電話、FAX、E-mail)
- 5) 発表を希望する討論主題
- 6) 希望発表形態 (口頭・ポスター)

シンポジウム HP

<https://pcat.cat.hokudai.ac.jp/fb/>

原稿提出締切 2019 年 10 月 18 日 (金)

原稿は和文または英文で、A4 用紙 1~4 ページとします。和文の場合には、英文要旨をつけるとともに、図表とそれらのキャプションは英語で記述願います。原稿のテンプレートはシンポジウム HP

よりダウンロードしてご使用願います。

事前参加申込締切 2019年11月15日(金)

参加申込みはシンポジウム HP からお願いします。講演申込みをされた方も別途、参加申込みが必要になります。

参加費

会員種別	11/15 まで	11/16 以降
主催・共催・協賛団体の正会員・ 法人会員・法人会員会社の社員	10,000 円	13,000 円
シニア会員	4,000 円	7,000 円
学生(会員・会員外)	5,000 円	6,000 円
会員外(学生を除く)	20,000 円	23,000 円

- ・シニア会員とは、もともと主催・共催の学会に所属しており、現在は退職された方です。
- ・お支払いは銀行振り込みとなります。振込先はシンポジウム HP にてお知らせします。
- ・お支払いは事前払いをお願いします。

懇親会費

- ・11月28日(木)に懇親会を開催します。懇親会費は5,000円(学生の参加登録者は無料)です。

発表形式

口頭またはポスター(討論を活性化する場合であれば、既発表の内容も歓迎します)。

[口頭発表]

- ・講演時間は1件当たり20分です(講演15分+討論5分)
- ・プロジェクタ、レーザーポインタ、マイクは当方にて準備しております。
- ・PCは講演者ご自身でお持込ください。

[ポスター発表]

- ・ポスター発表に先立ち、ショートプレゼンテーション(3分)を予定しています。
- ・ポスターボードは、縦2100mm×横900mmのボードを準備します。
- ・ポスター発表では、学生の発表を対象に優秀ポスター賞を贈賞します。
- ・ポスター会場、貼付け時間等の詳細は後日HPに掲載します。

お問い合わせ先

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1 大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻内
第25回流動化・粒子プロセッシングシンポジウム 事務局 辻 拓也(大阪大学)
E-mail : fb25@cf.mech.osaka-u.ac.jp